

エンベッディッド2D/3Dレーザースキャナー

VC nano 3D-Z

Dual-Core ARM® 及び Linux® OS搭載

様々なワークサイズに対応

レーザとスマートカメラを1つの筐体に統合し、ワークサイズに応じた作動距離の機種をラインアップ。

高輝度青色レーザモジュールにより、外来光の影響を取り除きます。

レーザ三角測距タスクに内部SoC ZynqモジュールのFPGAを使用しており、デュアルコアARMプロセッサをアプリケーションタスクに自由に使用が可能です。3Dポイントクラウドが1Gbitインターフェイスを介して転送され、PC上で処理することができます。

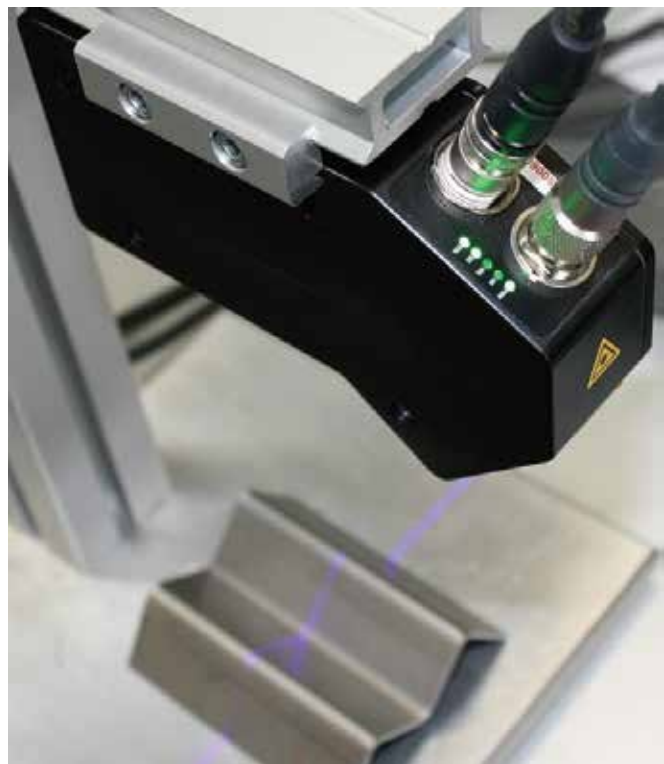


LINUX
Inside

FPGA
Power

デュアルコアARMプロセッサ + Linux OS搭載

3D点群データを1Gbitイーサネットで出力 コントローラ不要! 本体のみで動作



外光の影響を受けにくい
青色レーザーを採用

■主な用途

- 幅、厚み、高さ、角度測定
- 郵便物の大きさの測定
- スーツケース/荷物の、大型部品の測定
- 溶接継ぎ目、ビード等の高精度検査
- 食品のポリウム検査

■特徴

- 異なるワークサイズに対応する機種をラインナップ
- 外光の影響の少ない10万ルクス青色レーザー搭載
- FPGAで3D処理。ARMプロセッサをにアプリケーションに使用可能
- 点群データを1Gbit I/Fで出力

■主な仕様

- スキャンレート: ~ 2KHz
- レーザークラス 2
- 波長: 450 nm 青色レーザーライン
- 出力: 130 mW
- プロセッサ: Zynq デュアルコアARM + FPGA
- I/F: 6 インプット、4 アウトプット、400mA、1Gbitイーサネットエンコーダー
- 電源電圧: 24V ±20%
- 寸法 (標準品): 138 x 81 x 35 mm、約400g

*VC nano 3D-Zシリーズは、アプリケーションに応じて製品ラインアップを取り揃えています。各機種は作動距離と分解能が最適化されています。

焦点距離/角度	8/30 標準	8/34 標準	8/30 Large	8/34 Large	8/30 X Large	8/34 X Large	8/30 XX Large	8/34 XX Large	6/32 標準
最小距離 Z (mm)	90	80	170	150	285	245	460	400	70
最大距離 Z (mm)	245	195	470	375	785	625	1285	1020	285
最小距離 X (mm)	65	65	130	120	215	200	350	325	80
最大距離 X (mm)	150	125	295	240	495	400	810	660	230
最小解像度 X (μm)	60	50	110	100	170	160	280	260	70
最大解像度 X (μm)	120	100	240	190	390	320	640	520	190
最小解像度 Z (μm)	10	10	20	20	30	30	40	40	10
最大解像度 Z (μm)	40	30	80	60	130	90	220	150	70

